

1241152-4 ✓ 有效

AMPMODU | AMPMODU HV-100/HV-190

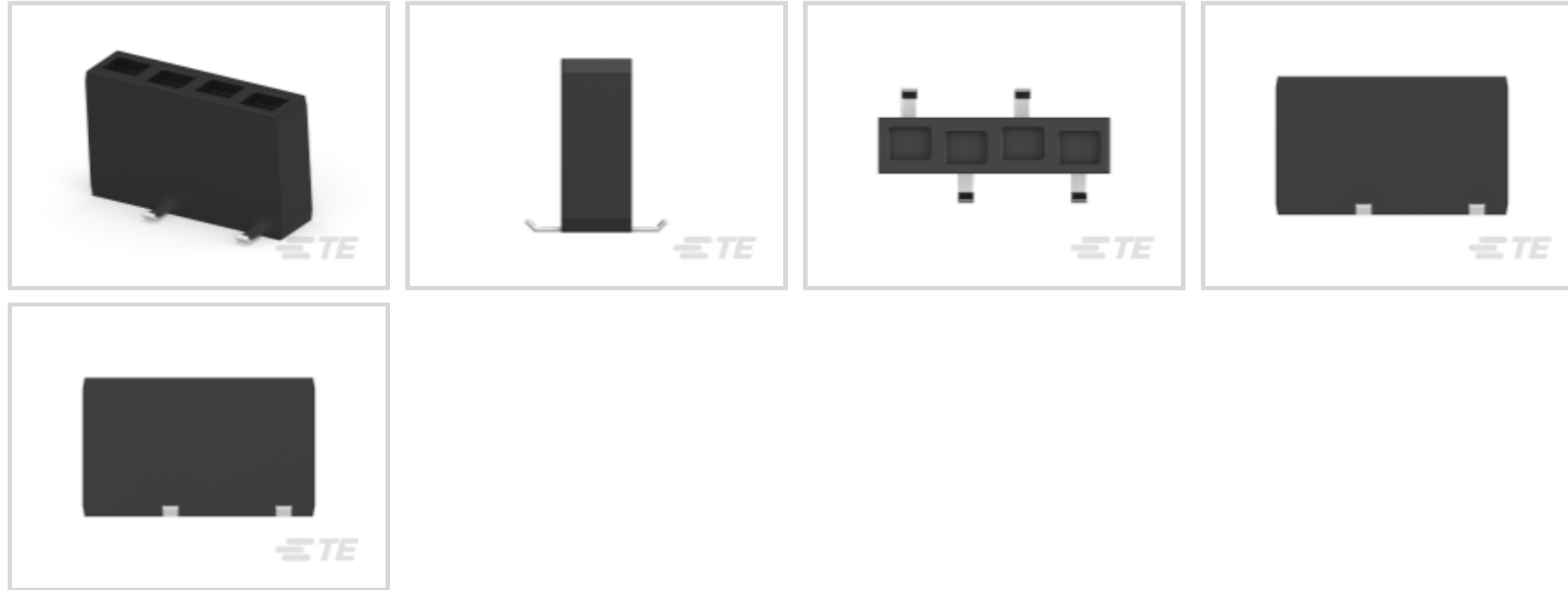
TE 内部编号 1241152-4

PCB Mount Receptacle, Vertical, Board-to-Board, 4 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Gold, Surface Mount, Signal, Black, AMPMODU HV-100/HV-190

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



连接器系统: 板对板

位数: 4

行数: 1

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

PCB 安装方向: 垂直

## 产品特性

### 产品类型特性

连接器系统	板对板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装母端

### 结构特性

板对板配置	平行
可堆叠	是
位数	4
行数	1
PCB 安装方向	垂直

### 主体特性

连接器外形	标准
主要产品颜色	黑色

### 接触件特性

端子保护类型	闭合入口壳体
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.5 $\mu$ m
端子布局	直插式
接合插针直径	.63 mm[.025 in]
端子接合区域电镀材料厚度	.762 $\mu$ m[30 $\mu$ in]
端子基材	磷青铜
端子接触部电镀材料	金
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	3 A

### 端接特性

矩形端接柱体和尾部厚度	.2 mm[.008 in]
矩形端接柱体和尾部宽度	.7 mm[.027 in]
PCB 端接方法	表面贴装

### 机械附件

连接器安装类型	板安装
接合对准	不带
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带

### 壳体特性

接合入口位置	底部和顶部
外壳材料	LCP（液晶聚合物）
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

### 尺寸

堆叠高度	9 mm[.354 in]
连接器高度	6.2 mm[.244 in]
PCB 厚度（建议）	1.4 – 2.4 mm[.055 – .094 in]
行间距	2.54 mm[.1 in]

### 使用环境

工作温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
--------	----------------------------

### 操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

## 行业标准

UL 阻燃性等级

UL 94V-0

## 包装特性

封装方法

Reel

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)  
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)  
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

回流焊接可达到 260°C

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



TE 产品编号 1241150-4  
4P MOD II BREAK AWAY HDR, SMD,  
BLISTER



TE 产品编号 826646-4  
4P AMPMODU II STIFT LEI



TE 产品编号 826629-4  
4P AMPMODU II PIN HSG



TE 产品编号 826648-4  
4P AMPMODU II STIFT LEI



该系列中的其他产品 | AMPMODU HV-100/HV-190



客户还购买了





## 文档

### 产品图纸

[4P HV100 REC. CON, SMD, GOLD, BLISTER](#)

英文版本

### CAD 文件

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1241152-4\\_D.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

#### 3D PDF

3D

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1241152-4\\_D.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1241152-4\\_D.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

### 数据表/目录页

[1773393\\_ AMPMODU\\_EUROPEAN\\_STANDARD\\_PRODUCTS](#)

英文版本